



Baumit FlexTop

Wysokoelastyczna zaprawa
klejowa do płytek 2–10 mm



- najwyższa trwałość na tarasach
- klejenie na stare płytki
- długi czas gotowości do pracy

Produkt

Wysokoelastyczna zaprawa klejowa na bazie szarego cementu o wydłużonym czasie otwartym, do stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Posiada certyfikat EMICODE EC 1 PLUS.

Właściwości

Wysokoelastyczna, wodo- i mrozoodporna, hydraulicznie wiążąca, ulepszona, tiksotropowa, cienkowarstwowa zaprawa klejowa, o podwyższonej wytrzymałości na odkształcenia poprzeczne.

Przeznaczenie

Do przyklejania ściennych i podłogowych płytek ceramicznych każdego typu i formatu, mozaiki, płytek gresowych oraz płyt z włókna szklanego, lekkich płyt budowlanych oraz twardych płyt styropianowych. Nadaje się do stosowania na podłożach odkształcalnych i o podwyższonych wymaganiach, w obrębie pomieszczeń mieszkalnych (w tym na ogrzewanie podłogowe) oraz budynków użyteczności publicznej, tarasów, elewacji, basenów i zbiorników wodnych. Dopuszczona do kontaktu ze środkami spożywczymi.

Dane techniczne

Klasyfikacja:	C2TE S1 wg PN-EN 12004:2002
Czas obróbki:	do 4 godz.
Czas otwarty:	do 30 min.
Czas dojrzewania:	ok. 15 min.
Czas korekty:	do 5 min.
Max. grubość warstwy:	10 mm
Min. grubość warstwy:	2 mm

	FlexTop 25 kg
Zużycie	ok. 3 kg/m ² w zależności od rodzaju płytek
Zapotrzebowanie wody	ok. 6 l/25 kg

Paca zębata:	3 mm	6 mm	10 mm
Zużycie około:	1,5 kg/m ²	2,5 kg/m ²	3,5 kg/m ²



Opakowanie

Worek 25 kg, 42 wor./pal. = 1050 kg

Przechowywanie

W suchym i chłodnym miejscu, na paletach drewnianych, przez okres 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na worku.

Gwarancja jakości

Stała kontrola jakości w laboratorium zakładowym.

Bezpieczeństwo

Należy zapoznać się z Kartą Charakterystyki produktu (Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31) dostępną na żądanie klienta lub na stronie www.baumit.pl

Podłoże	Podłoże musi być czyste, suche, nieprzemarznięte, odpylone i odtłuszczone, wolne od wykwitów, nośne i pozbawione luźnych cząstek. Zaprawę można stosować na: beton, jastrych, gazobeton, klinkier, gotowe tynki cementowe i gipsowe, kartonowe płyty gipsowe, gipsowe ścienne płyty budowlane, jastrychy anhydrytowe (odpowiednio zagruntowane). Nie stosować na: drewno, metal, tworzywa sztuczne, podłoża na bazie cementu przed zakończeniem procesów wiązania.
Przygotowanie podłoża	Podłoże oczyścić z pyłu, kurzu, oraz zagruntować odpowiednim preparatem : w przypadku podłoży chłonnych - Baunit Grund, w przypadku podłoży niechłonnych - Baunit SuperPrimer.
Obróbka	<p>Zalecane narzędzia: Wolnoobrotowe mieszadło elektryczne, paca zębata, kielnia, gąbka paca 3 x 3 mm - klejenie mozaiki paca 6 x 6 mm - klejenie płytek o spodzie gładkim paca 10 x 10 mm - klejenie płytek o spodzie profilowanym</p> <p>Wsypać zawartość worka do odpowiedniej ilości czystej wody i mieszać przez ok. 3 min. czystym, wolnoobrotowym mieszadłem do uzyskania jednorodnej masy. Odczekać ok. 15 minut i ponownie przemieszać zaprawę. Używając odpowiedniej pacy zębatej, nanosić zaprawę klejową równomiernie na podłoże (pacę utrzymywać podczas rozprowadzania materiału pod kątem 45 stopni do podłoża). Kleić wyłącznie świeżą zaprawą, ewentualne jej pozostałości usuwać zwilżoną gąbką.</p> <p>Zalecane pokrycie spodu płytki klejem (wypełnienie przestrzeni podpłytkowej):</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ wewnątrz budynków > 65% ■ na zewnątrz budynków oraz przy ogrzewaniu podłogowym > 90% <p>Zapewnienie pełnego kontaktu płytki z klejem można otrzymać poprzez układanie płytek metodą kombinowaną (BUTTERING – FLOATING), polegającą na nanoszeniu zaprawy klejowej zarówno na podłoże jak i na spód płytki.</p> <p>Przez ok. 48 godzin chronić klejoną powierzchnię przed obciążeniami mechanicznymi i termicznymi (nie chodzić i nie obciążać ułożonych płytek).</p>
Wskazówki	<p>Przestrzegać norm, wytycznych i innych informacji technicznych dotyczących podłoża i okładzin.</p> <p>Nie stosować w temperaturze poniżej + 5 °C lub powyżej +25 °C, w deszczu, przy bezpośrednim nasłonecznieniu, silnym wietrze lub przeciągach. Chronić do czasu pełnego utwardzenia.</p> <p>Wysoka wilgotność powietrza i niskie temperatury wydłużają przewidziany czas schnięcia, wysokie temperatury skracają czas wiązania i utwardzania!</p> <p>Nie dodawać żadnych innych materiałów!</p> <p>Nie moczyć ani podłoża ani płytek.</p> <p>Bezwzględnie przestrzegać podanego czasu otwartego - schnięcia naniesionej na podłoże zaprawy klejowej. Po przekroczeniu tego czasu zaprawę należy usunąć.</p>

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane słowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (użytkownika) opracowane w oparciu o nasze doświadczenia i aktualny stan wiedzy są niewiążące i nie uzasadniają prawnego stosunku umownego oraz żadnych zobowiązań ubocznych z tytułu umowy kupna (sprzedaży). Nie zwalniają one nabywcy od sprawdzenia na własną odpowiedzialność przydatności naszych produktów do przewidzianego zastosowania. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie możliwość zmian, które służą technicznemu postępowi i ulepszeniu produktu lub jego zastosowaniu. Wraz z ukazaniem się niniejszej informacji technicznej wcześniejsze jej wersje tracą ważność. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie Państwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowiązują nasze „Ogólne warunki umów” znajdujące się w katalogach produktów. Nasza gęsta sieć Przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasięgnąć u najbliższego Przedstawiciela Handlowego.